

図 - 18 低粘性流体が発生したことに対する要因の分析フロー

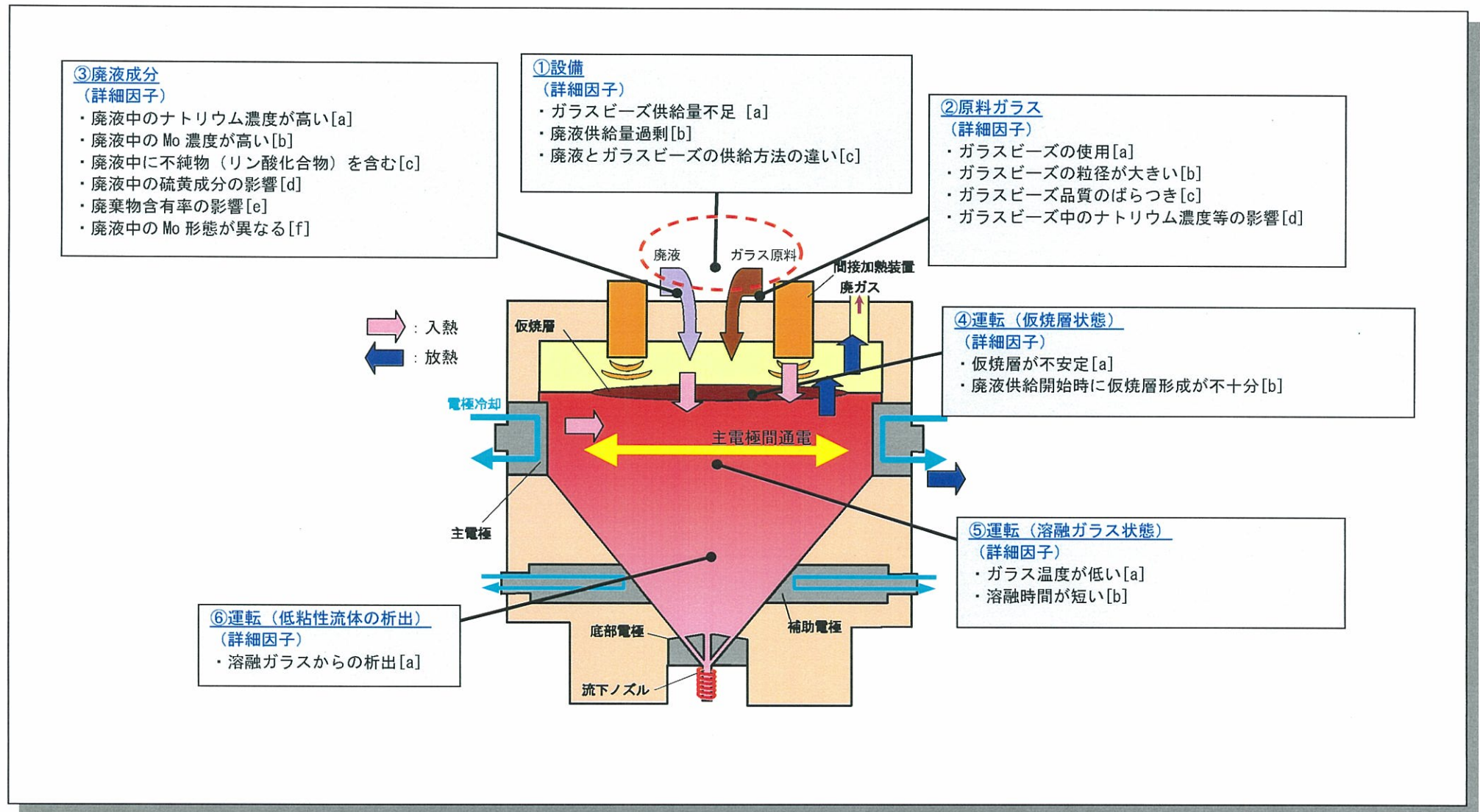


図 - 1 9 低粘性流体の発生に影響を及ぼす要因の詳細因子

(溶融温度: °C)


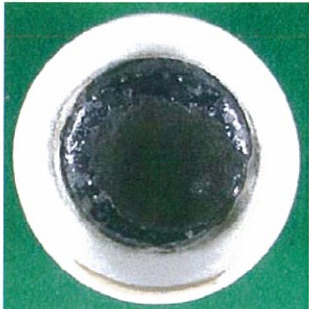
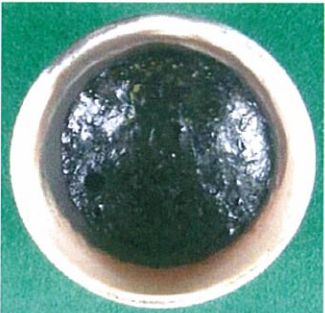

高模擬廃液、添加なし	高模擬廃液、DBP(<input type="text"/> mg/L 相当)
 <p data-bbox="448 703 560 734">生成有り</p>	 <p data-bbox="895 703 1310 734">生成有り (添加なしよりやや多い)</p>
高模擬廃液、(硫黄含有)	高模擬廃液、(硫黄含有 硫黄の量は左記試験の 10 倍)
 <p data-bbox="284 1162 703 1193">生成有り (添加なしよりやや多い)</p>	 <p data-bbox="999 1171 1203 1202">生成有り (多い)</p>

図 - 20 低粘性流体生成状況 (るつぽ試験)








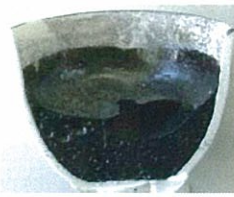
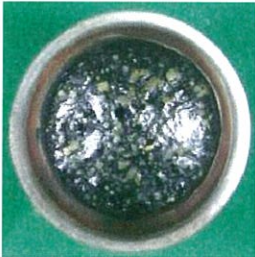


□°Cまで昇温、昇温速度は□~□°C			
10°C/min	5°C/min	1°C/min	0.2°C/min
			
			
生成有り	表面に生成有り	表面に生成有り	生成無し

図-21 昇温速度と低粘性流体生成の関係（るつぼ試験）

加熱保持温度	□°C	□°C	□°C
表面状態			
低粘性流体の生成	生成有り	生成有り	生成無し

表面浮遊物は白金族元素

図-22 加熱保持温度と低粘性流体生成の関係（るつぼ試験）

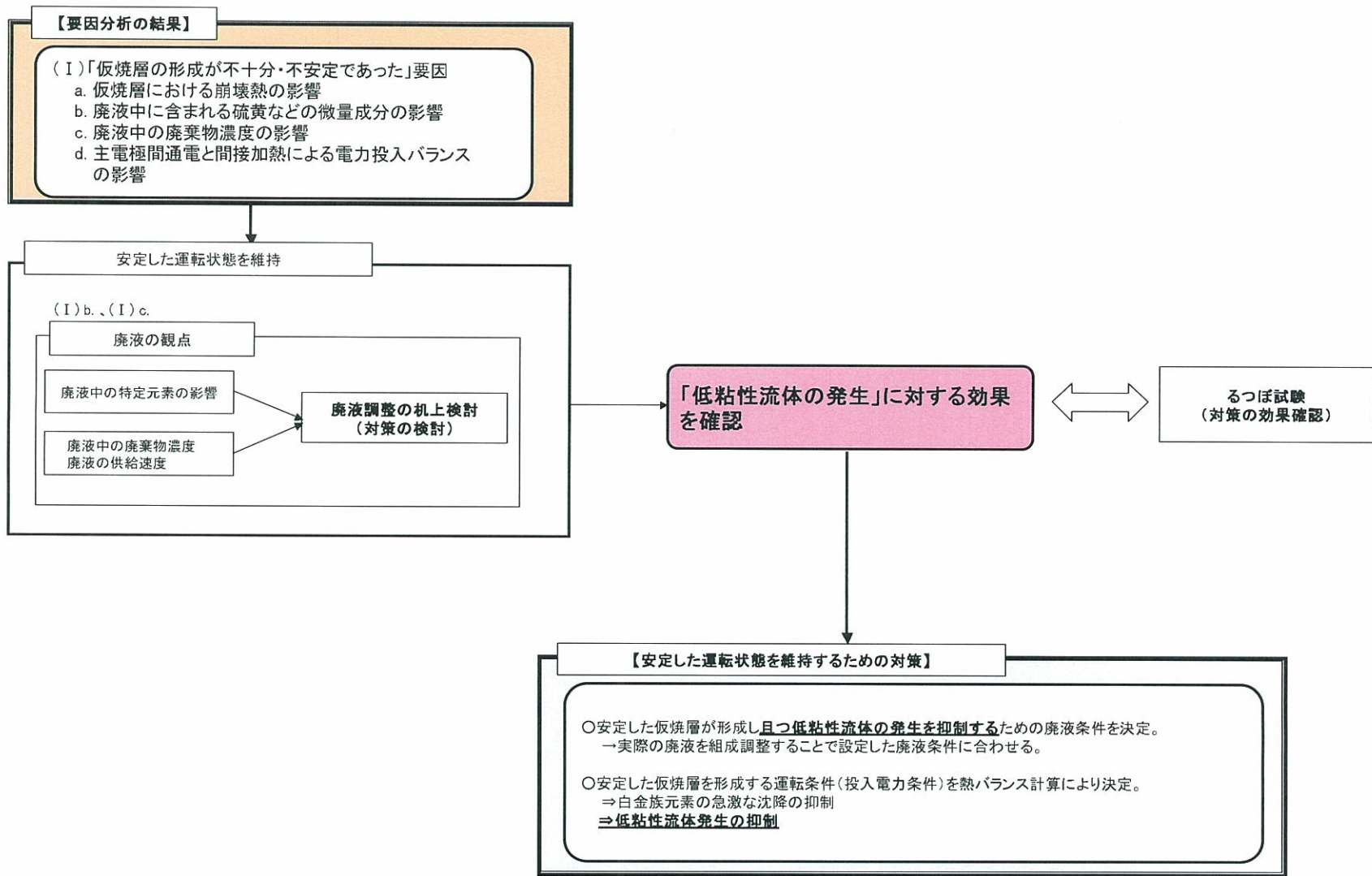
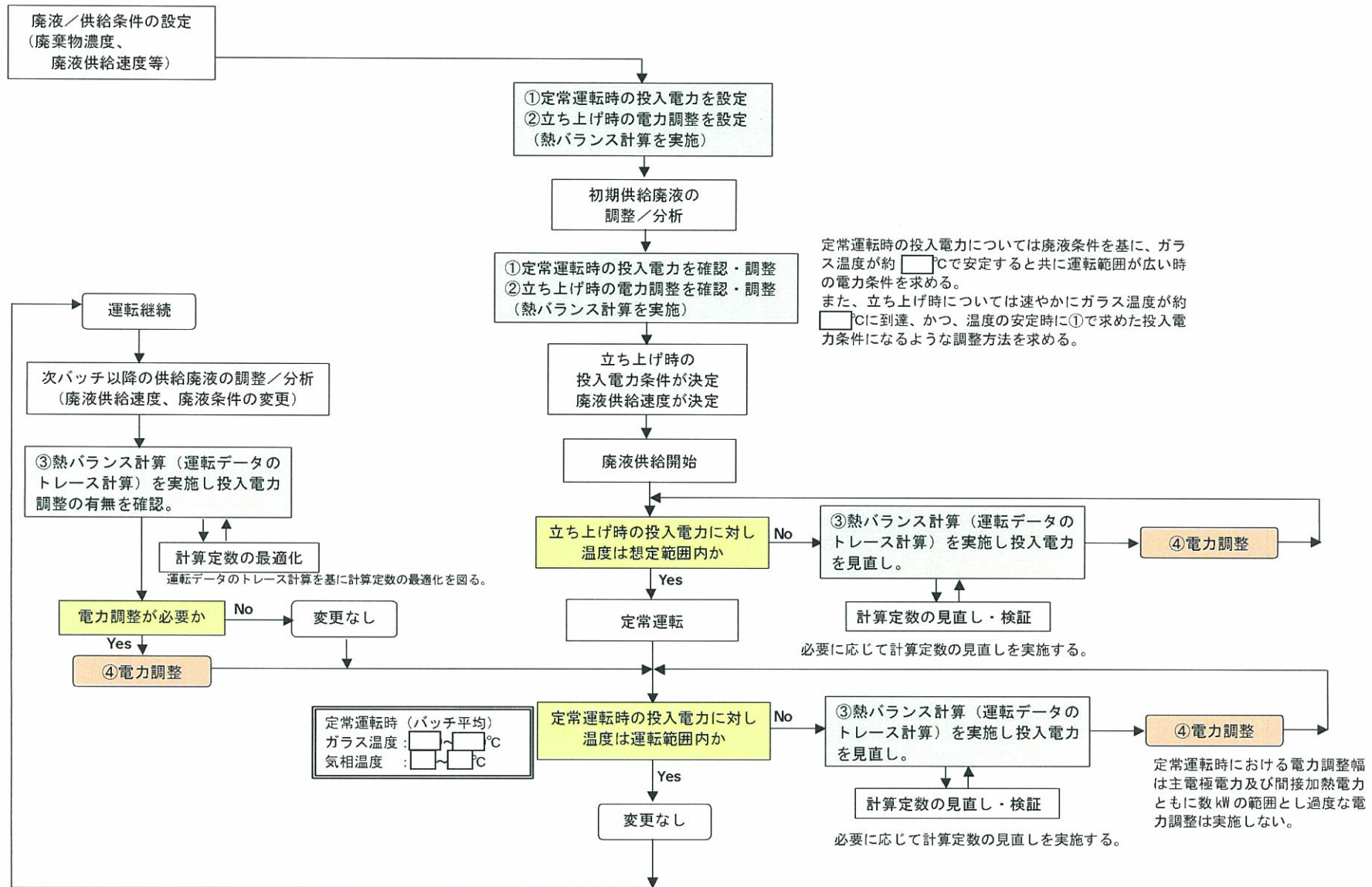


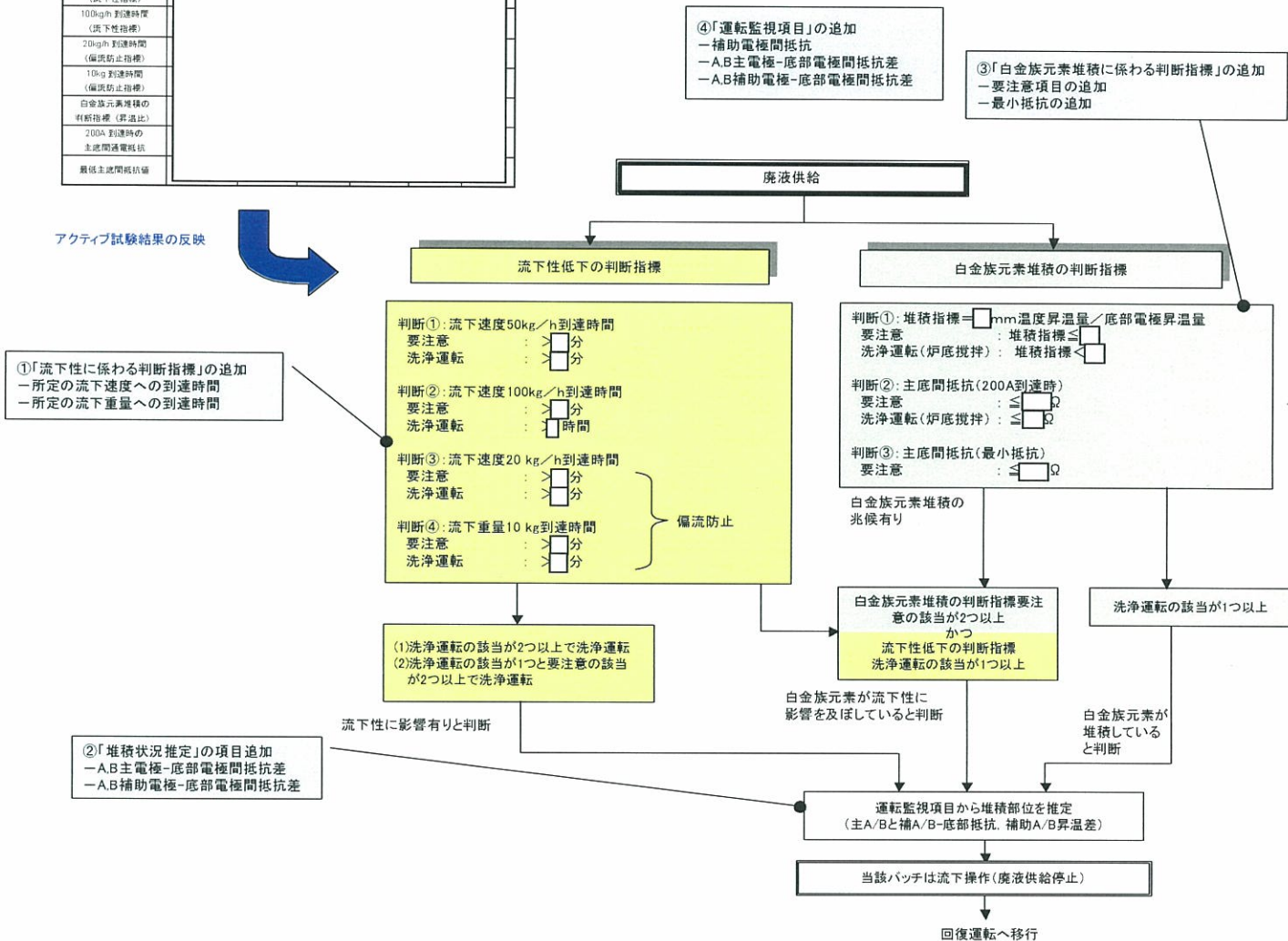
図-23 低粘性流体発生要因に対する対策の検討フロー



図—24 安定した運転を維持するための具体的対策 (投入電力調整)

	流下性			判定値		
	化学試験時 (目標値)	AT 実績	次回 AT	化学試験時	AT 実績	次回 AT
50kg/h 到達時間 (流下性指標)						
100kg/h 到達時間 (流下性指標)						
20kg/h 到達時間 (偏流防止指標)						
10kg 到達時間 (偏流防止指標)						
白金族元素堆積の 判別指標 (許容比)						
200A 到達時の 主底間電極抵抗						
最低主底間抵抗値						

アクティブ試験結果の反映



図—25 回復運転への移行判断フロー